

臻鼎科技控股 (4958 TT)

投資人簡報

2026年01月



免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

一分鐘認識臻鼎



全球第1大

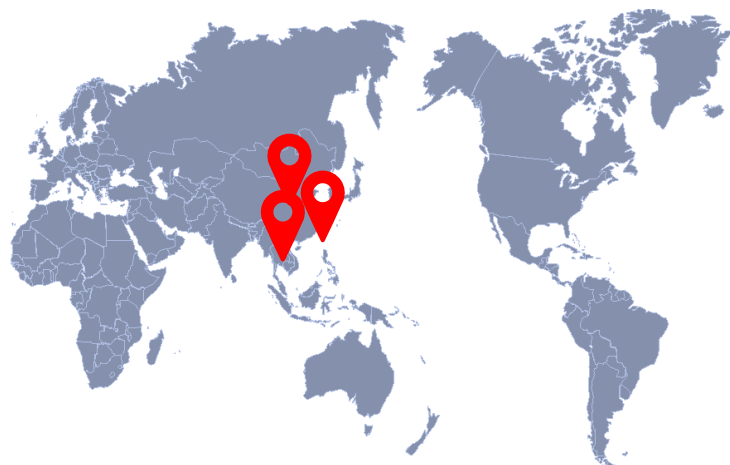
印刷電路板製造公司

2006年 成立
(前身華虹電子 1978)

48,141
2024年底員工數



台灣桃園 總部



28 棟工廠
位於大陸、台灣、泰國，
其中 **19** 棟為智能工廠

NT\$1,825.2億

2025年營收(6.3% YoY)

NT\$1,520億

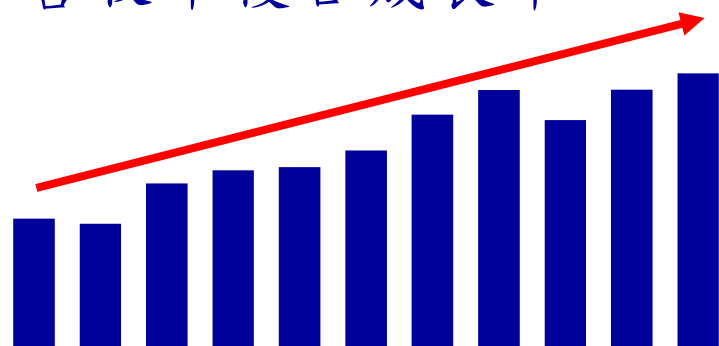
2025年12月31日市值

13.3%

10年平均股東權益報酬率
(2015-2024)

+8%

2015-2025年
營收年複合成長率

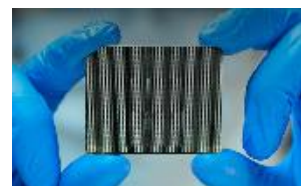


未來關鍵成長動能

AI伺服器



IC載板



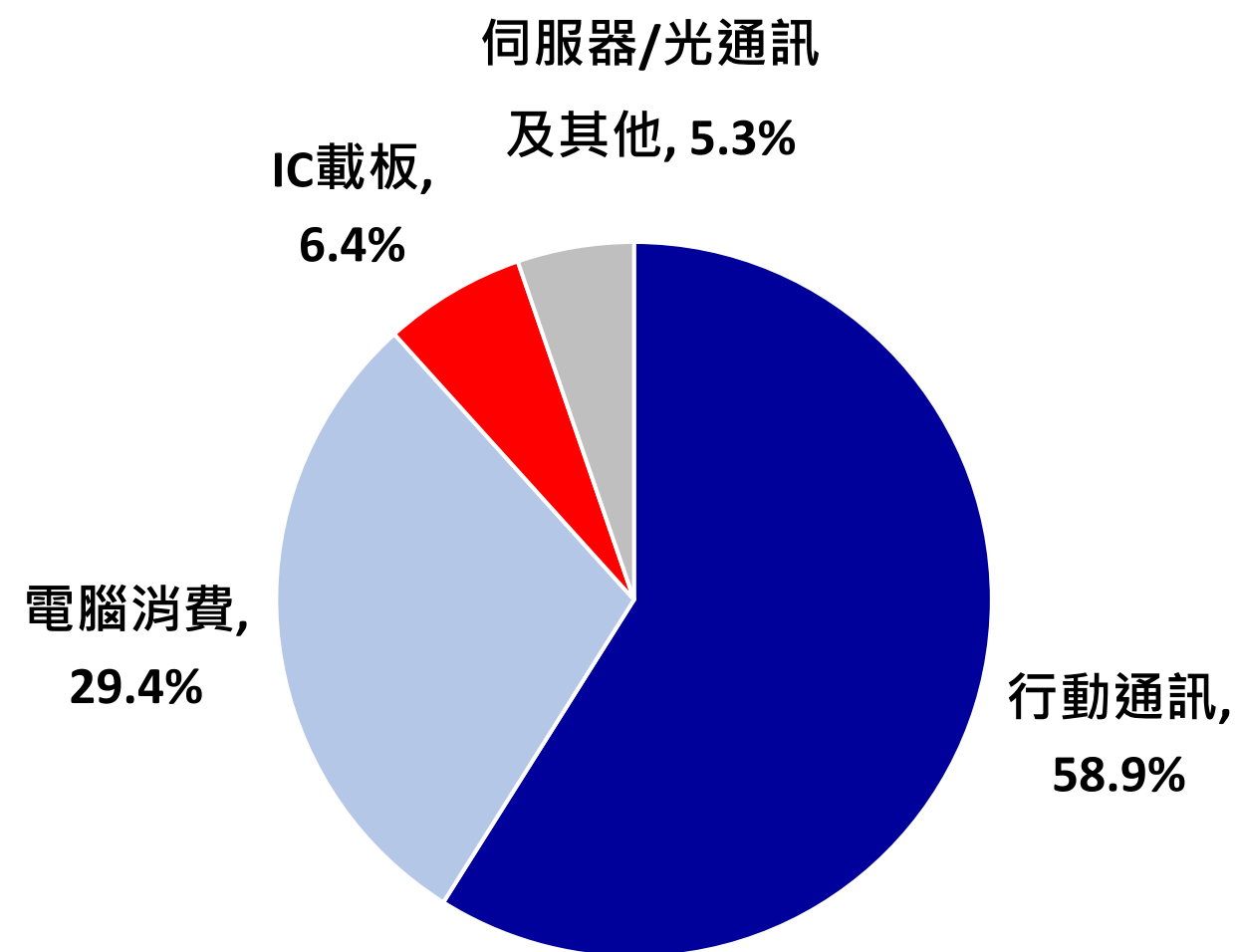
光通訊



邊緣AI



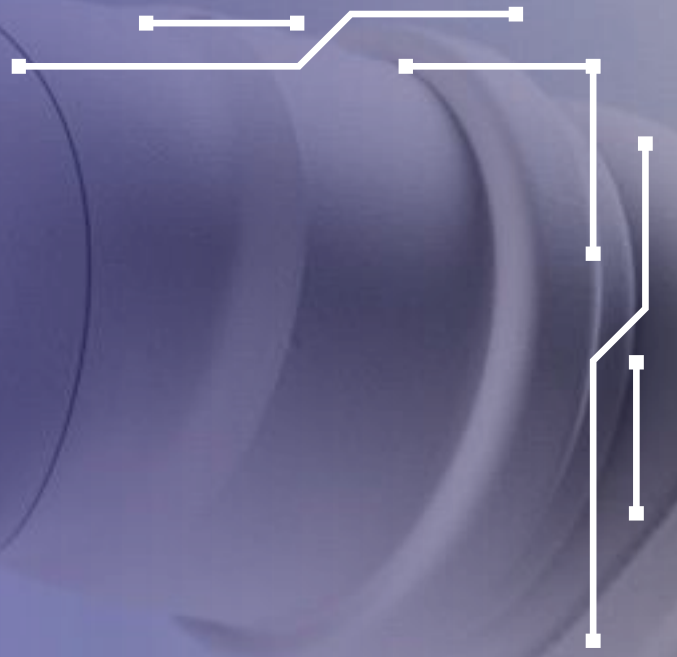
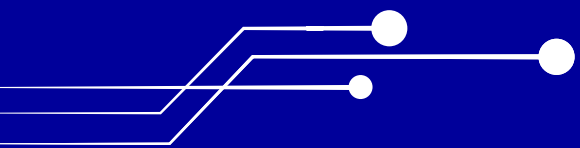
銷售分析-產品應用別 (3Q25)





臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

營運概況重點更新



營運成果回顧暨未來展望

1

第三季與前三季營運表現保持穩健：2025年第三季營收年減6.4%，主要受匯兌因素所影響，若以美元計算，第三季營收年增0.6%。第三季毛利率22.0%，較去年同期減少0.5個百分點，主要因公司持續投資AI算力相關產能，因此折舊/營收占比較去年同期增加0.6個百分點所致。累計前三季營收年增8.8%並創下歷年同期新高，四大應用同步年增，其中IC載板年增30%，成長幅度最大。前三季毛利率與營業利益率分別較去年同期年增0.3與1.2個百分點。

2

第四季將符合過往季節性，站上今年高峰，2025年營收表現將再創新高：第四季仍是客戶新品出貨旺季，出貨節奏正常，產能利用率將維持高檔。另外IC載板方面，不僅BT載板2H25需求明顯成長，平均產能利用率達90-95%，且ABF載板來自大尺寸的營收貢獻逐漸上升，打樣數量亦大幅增加。

3

樂觀看待2026年營運表現，四大應用全面加速成長：積極佈局AI伺服器應用，提供Intelligent HDI (iHDI) 與HLC產品，主要以客戶下一代平台為重點耕耘方向，預期2026年AI伺服器營收將逐步放大，2027年將會倍數成長。IC載板方面，1H26將啟動秦皇島廠區BT載板擴產，以滿足客戶需求，另外隨著ABF載板AI 算力相關大尺寸產品打樣數量大幅增加，預期2026年營收貢獻將逐季大幅攀升。邊緣AI裝置方面，明年不僅AI 手機與摺疊機新品因產品設計更複雜、規格升級，單機板價值 (dollar content) 將進一步提升，在AI眼鏡方面，隨著各大廠加速投入，相關營收明年將數倍成長。

4

積極擴充產能，滿足客戶高階AI產品需求：在淮安與泰國園區積極擴充iHDI 與HLC產能，淮安廠區iHDI 與HLC產能至明年底將較現在翻倍成長；泰國一廠逐步量產爬坡中，預期2Q26達到滿產，目前泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔中心四座廠房同步建置，滿足客戶不斷上升的高階AI產品需求。高雄AI園區之高階ABF載板與iHDI+HLC產能陸續裝機試車，將於1Q26進入打樣階段。

邊緣AI相關應用



AI手機/折疊機

AI眼鏡/VR/AR

人形機器人

- 臻鼎為全球最大AI眼鏡PCB製造商，AI眼鏡相關營收在2025年成長數倍，隨著客戶需求不斷攀升，預期2026年將再成長數倍。
- 明年AI手機與摺疊機新品因產品設計更複雜、規格升級，單機板價值（dollar content）將進一步提升，挹注營運表現。
- 人形機器人對PCB的技術要求高，主要用於主控系統、感測器模組、電源管理、關節驅動等核心功能。目前臻鼎與多家大陸及國際客戶均已建立合作關係，持續進行產品開發與打樣，以高精度、高密度佈線產品滿足客戶高階PCB需求。

伺服器/光通訊相關應用

- 以淮安及泰國兩大量產廠區，提供客戶應用於AI伺服器的Intelligent HDI (iHDI) 與HLC產品，主要以客戶下一代平台為重點耕耘方向。
- 以高雄AI園區執行超高階產品的前期開發研究，與客戶針對未來2-3個世代平台的產品進行開發。
- 預期2026年AI伺服器營收將逐步放大，2027年將會倍數成長。

IC載板

- BT載板2H25需求明顯成長，平均產能利用率約90-95%，1H26將啟動秦皇島廠區擴產。
- ABF載板來自大尺寸的營收貢獻逐漸上升，9月時ABF載板營收中已有約75%來自AI算力相關產品，且打樣數量大幅增加，預期2026年營收貢獻將逐季大幅攀升。
- 高雄AI園區之高階ABF載板產能已經進入試車，將於1Q26進入打樣階段，承接全球客戶需求。

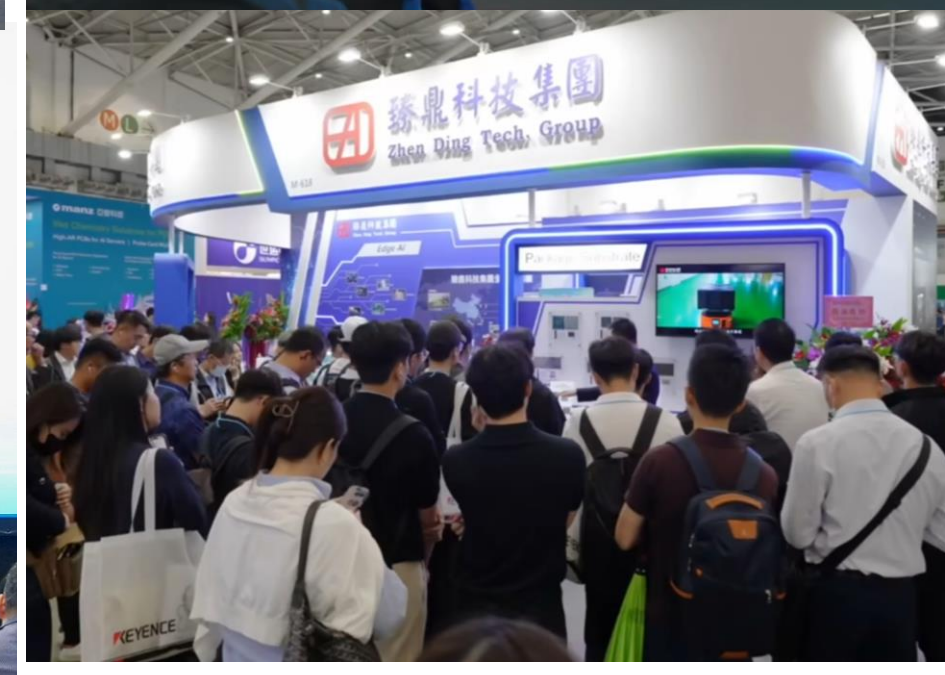
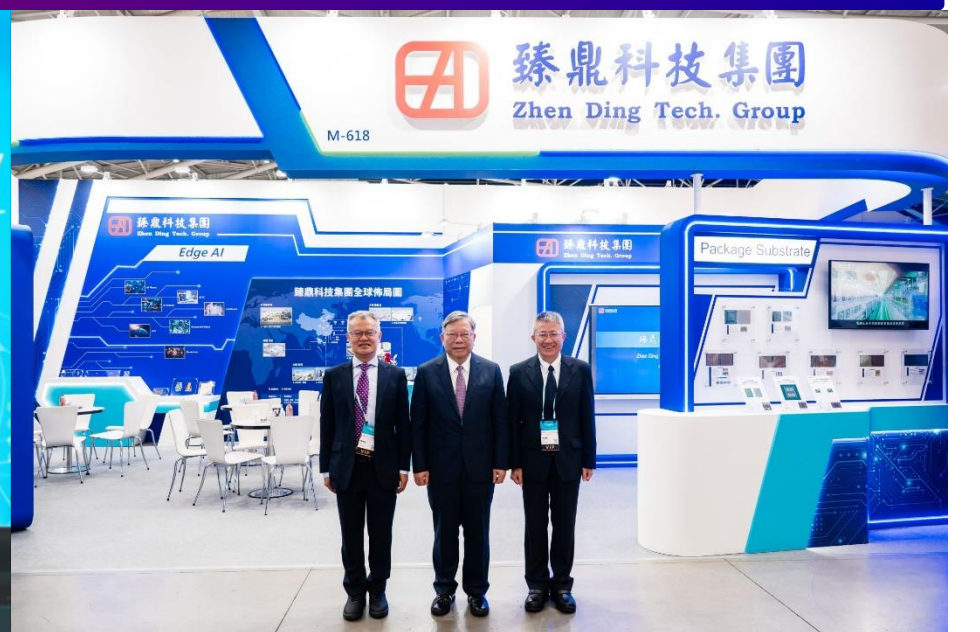
參與SEMICON Taiwan、TPCA雙展

展現臻鼎在PCB半導體化浪潮下的技術實力

再度參與SEMICON Taiwan 2025



首次參與TPCA Show 2025

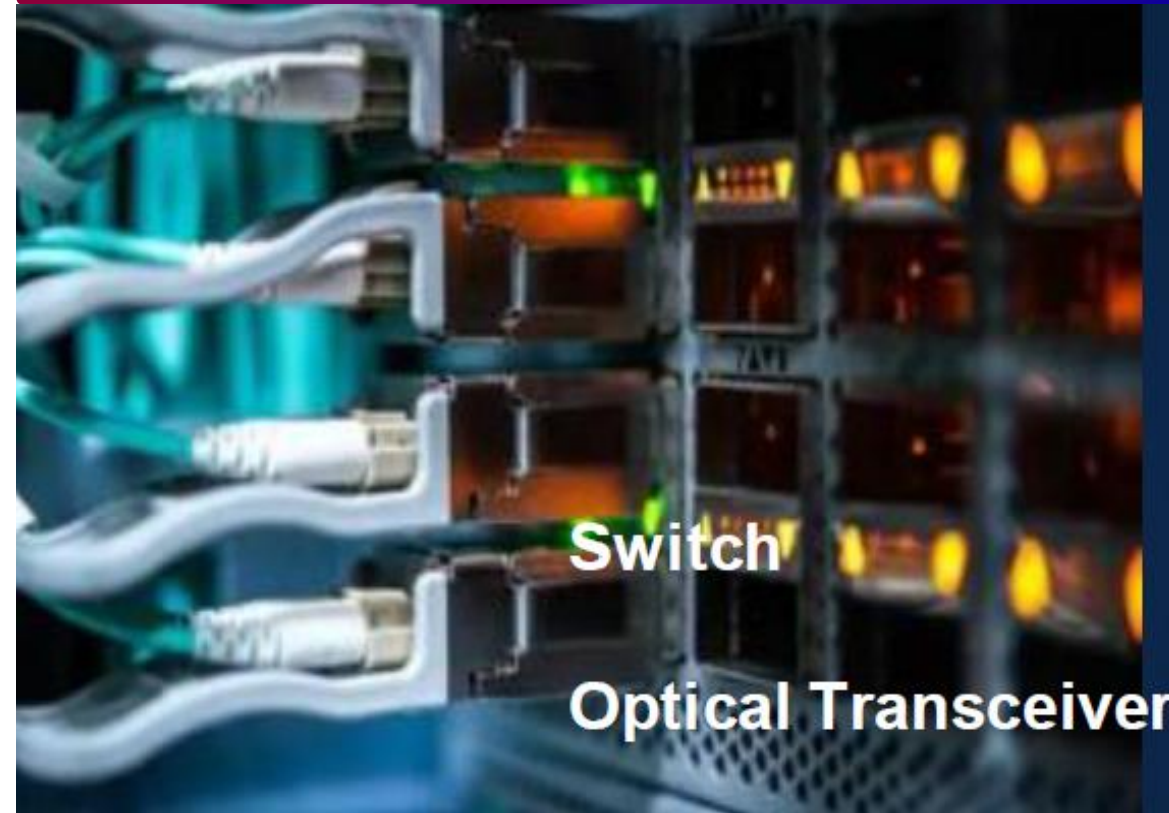


高階PCB到載板 ZDT提供完整的異質整合解決方案

雲



管



端



HLC

Intelligent HDI

ICS

High Accuracy
HDI

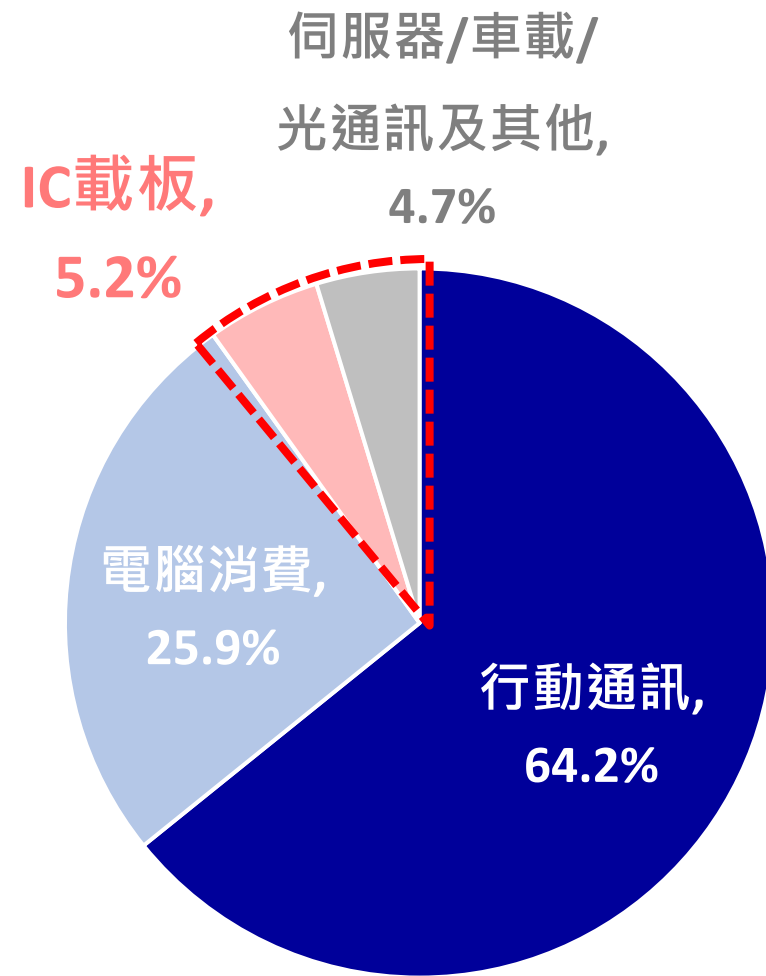
High Density

Big Size & High
Stacked Layers

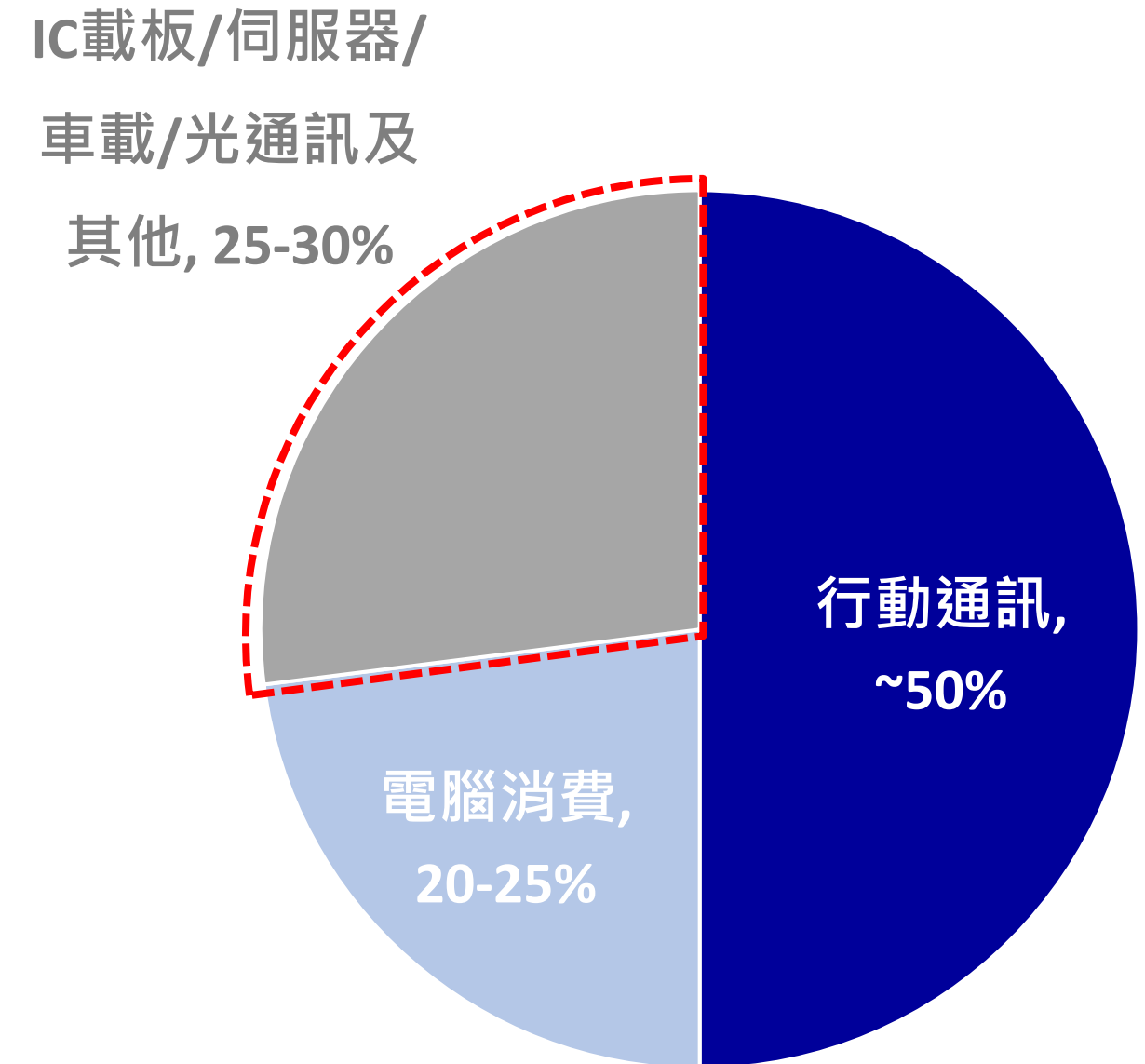
High Speed
Material

穩步推進伺服器與IC載板佈局，持續擴大營收貢獻

臻鼎：2024年產品應用營收佔比



臻鼎：2030年目標產品應用營收佔比



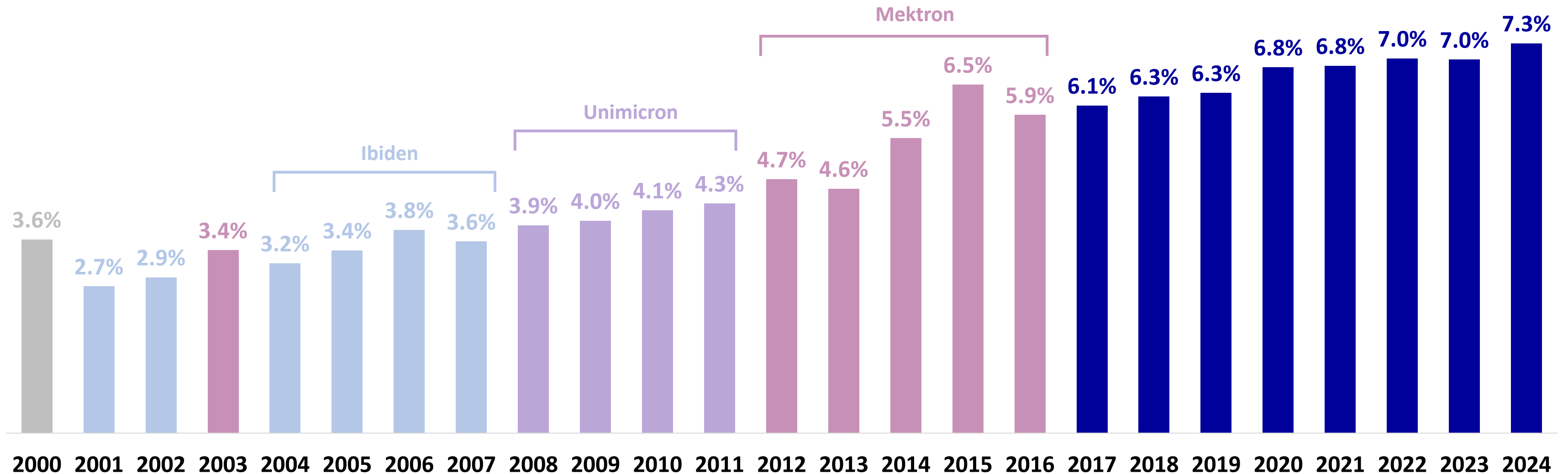
強化領先優勢，
擴大市場版圖

臻鼎持續居於產業領先地位

歷年全球最大PCB廠商市佔率

■ Sanmina ■ Ibiden ■ Mektron ■ UMTC ■ ZDT

臻鼎連續 8 年市佔率全球第一
(且為PCB產業歷年來首家突破7%市佔率的公司)

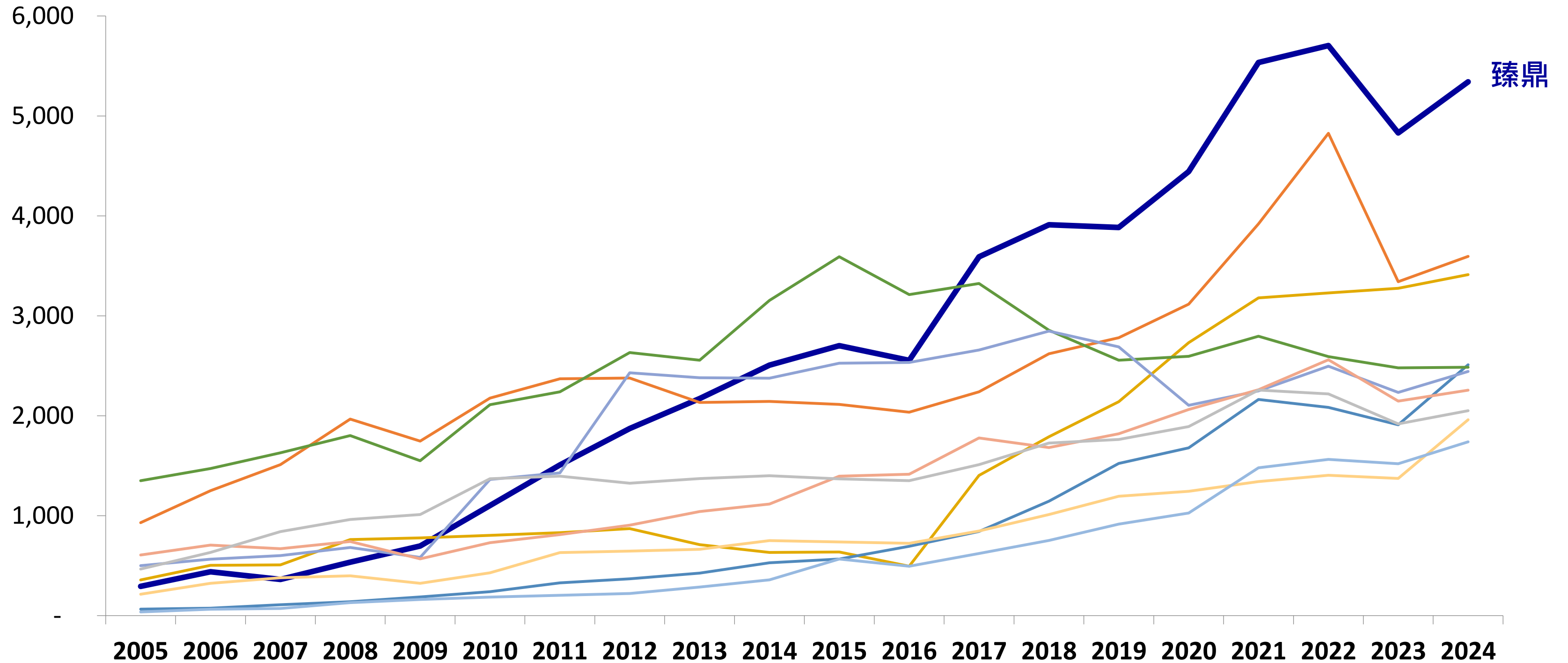


資料來源：Prismark

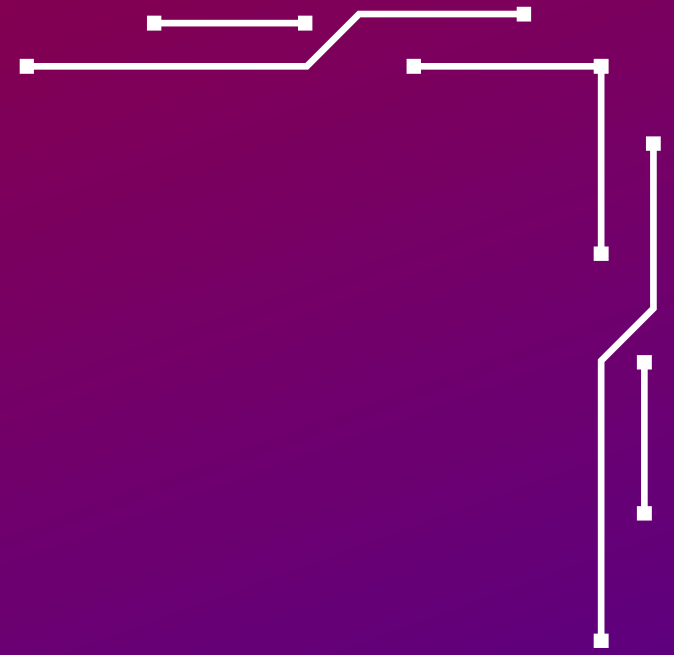
臻鼎保持與同業間的領先差距

2024年全球前十大PCB領導廠商營收趨勢

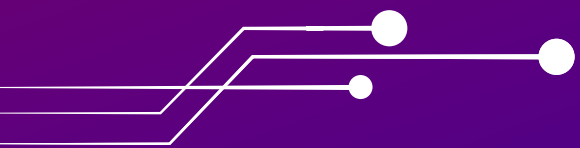
單位：百萬美元



資料來源：NT Information；Prismark (2025/03)

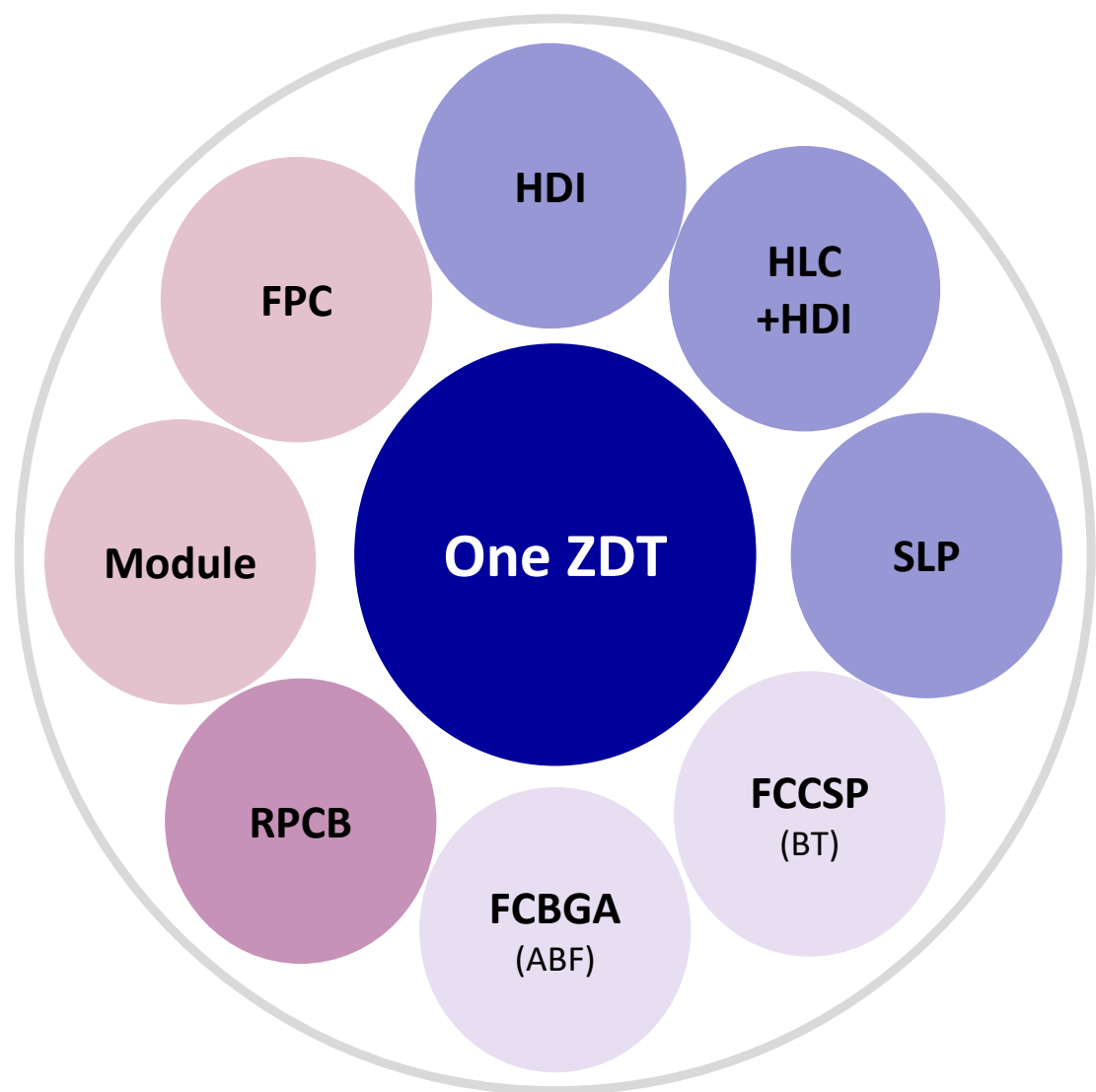


為何臻鼎能持續保持領先地位?



臻鼎：唯一橫跨全產品線的PCB領導者

憑藉One ZDT的全產品布局，臻鼎全面覆蓋AI時代的雲、管、端應用，提供最完整的解決方案，確保在PCB技術日益複雜的競爭中，穩居全球領導地位。



AI

雲



AI 伺服器



邊緣運算
伺服器



高速運算
記憶體

管



光通訊



交換器

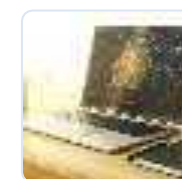


基地台

端



AI 手機/
晶片



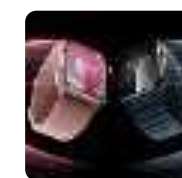
AI PC/
平板



人形
機器人



智慧眼鏡/
AR/VR



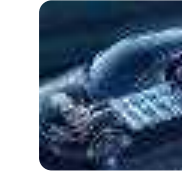
智能穿戴



智能車用
智慧座艙
域控制器



自動駕駛
車用晶片
毫米波雷達



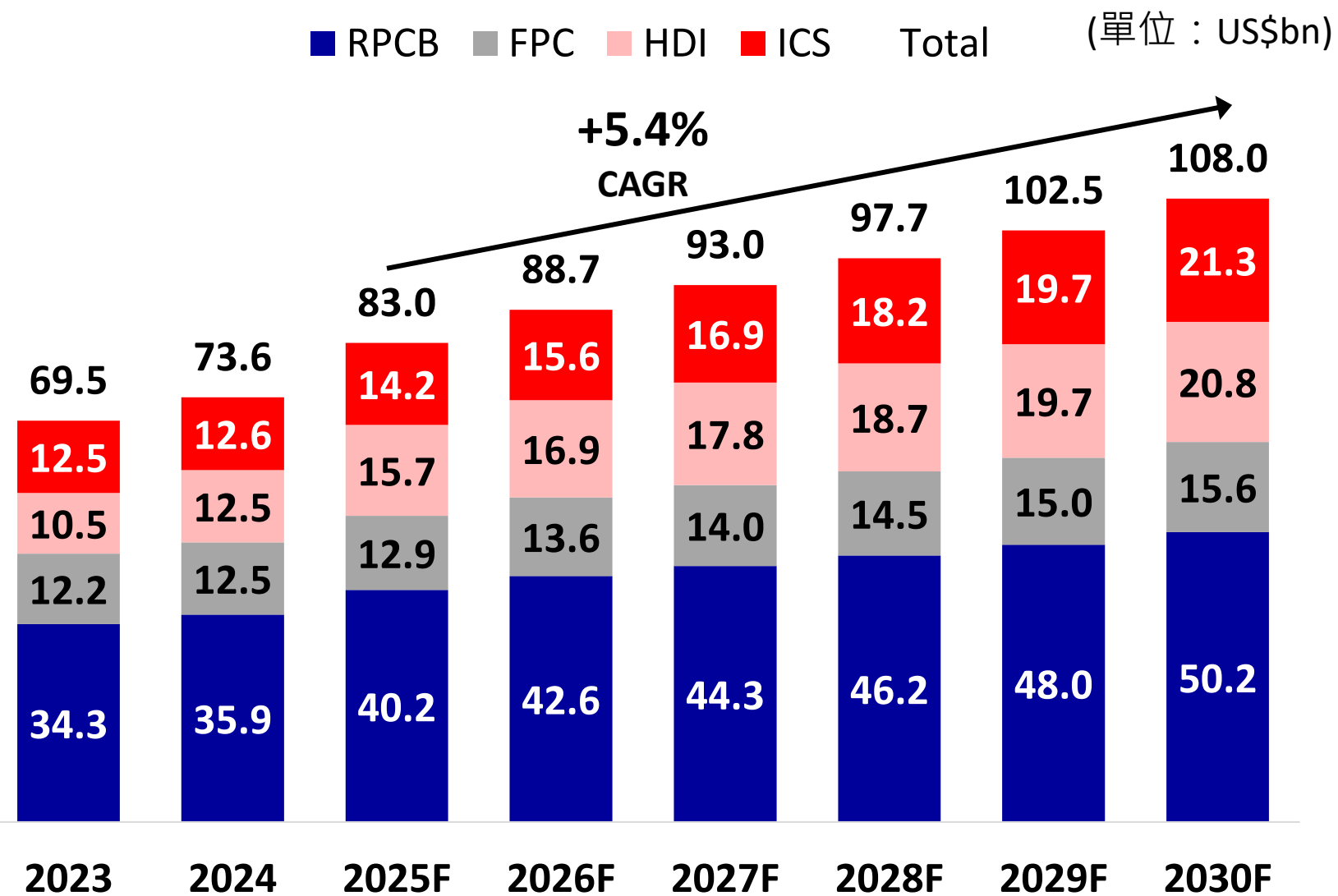
新能源車
電池板

AI是推動PCB產業成長的重要動能， 臻鼎將以全產品優勢在AI時代拉開與同業的領先差距

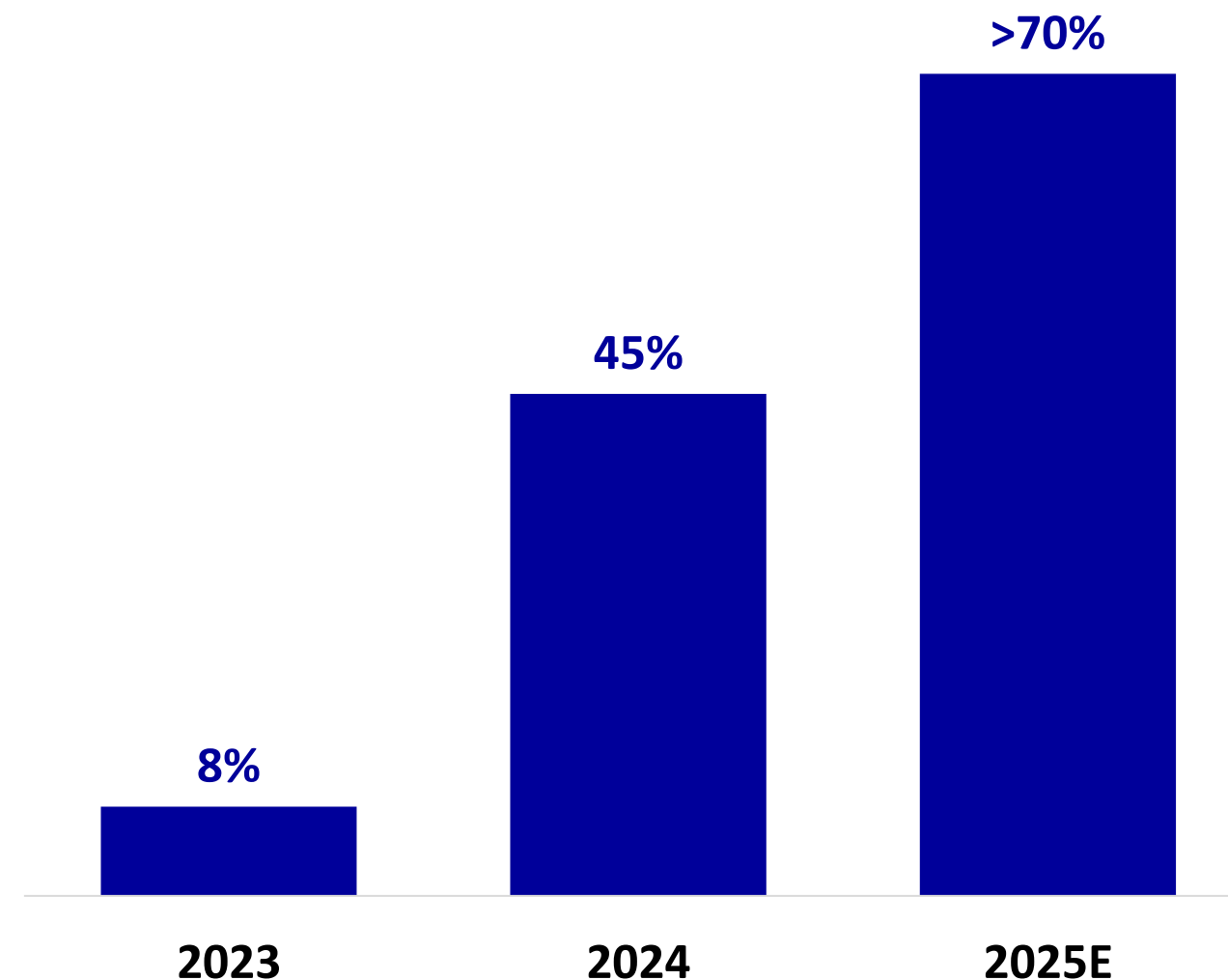
各類 PCB皆受益於 AI 帶來的高階性能要求與產品創新浪潮，AI仍將是PCB產業未來數年的核心成長動能

臻鼎全面覆蓋AI時代的雲、管、端應用，AI營收佔比逐步提高

全球PCB各產品市場規模

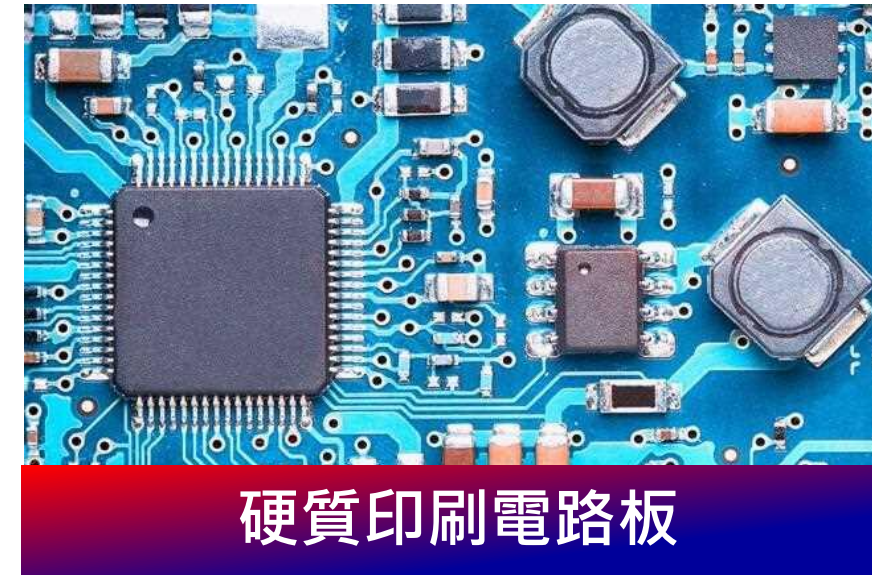
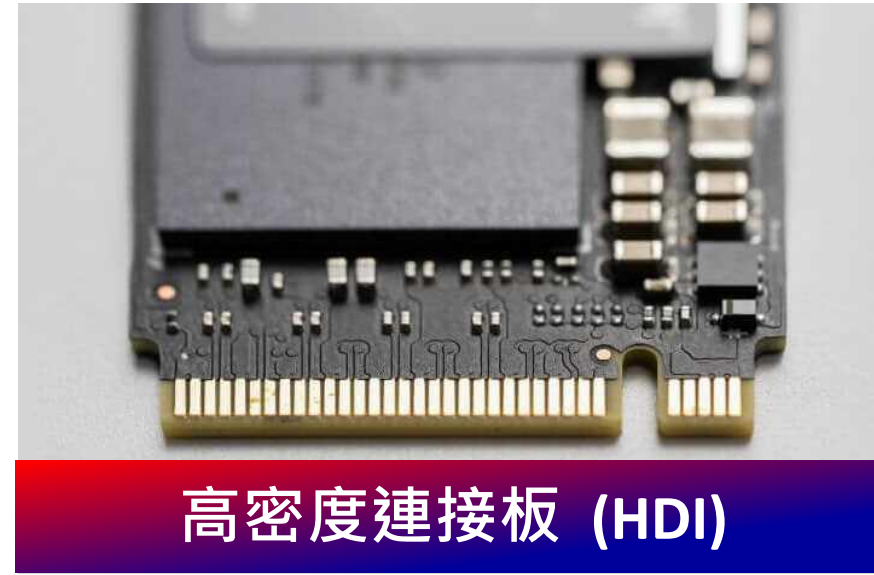
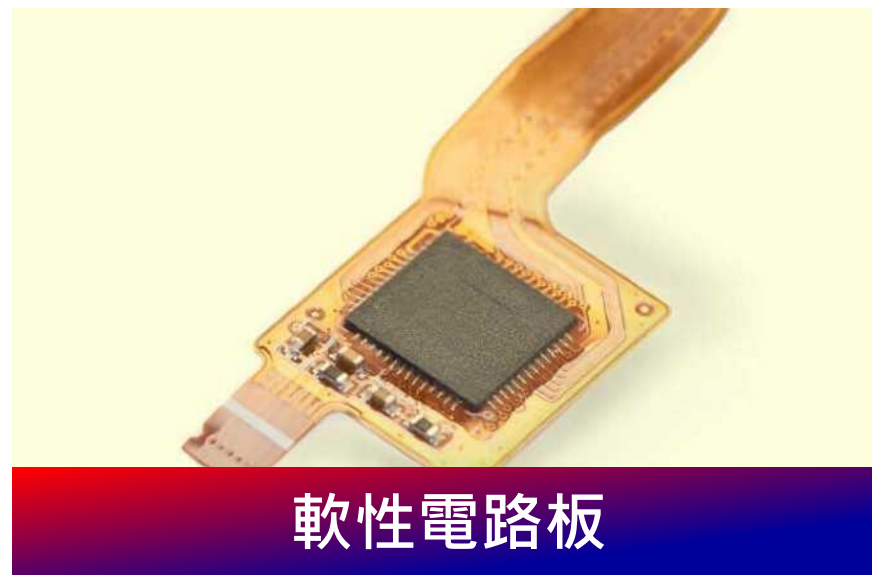


■ 臻鼎AI營收占比



資料來源：Prismark (2025/9)；2026~30年係用Prismark數據推估。

過去幾年耕耘逐步發酵，臻鼎四大產品線將持續成長



2030目標

全球前5

2030目標

保持#1

2030目標

全球#1

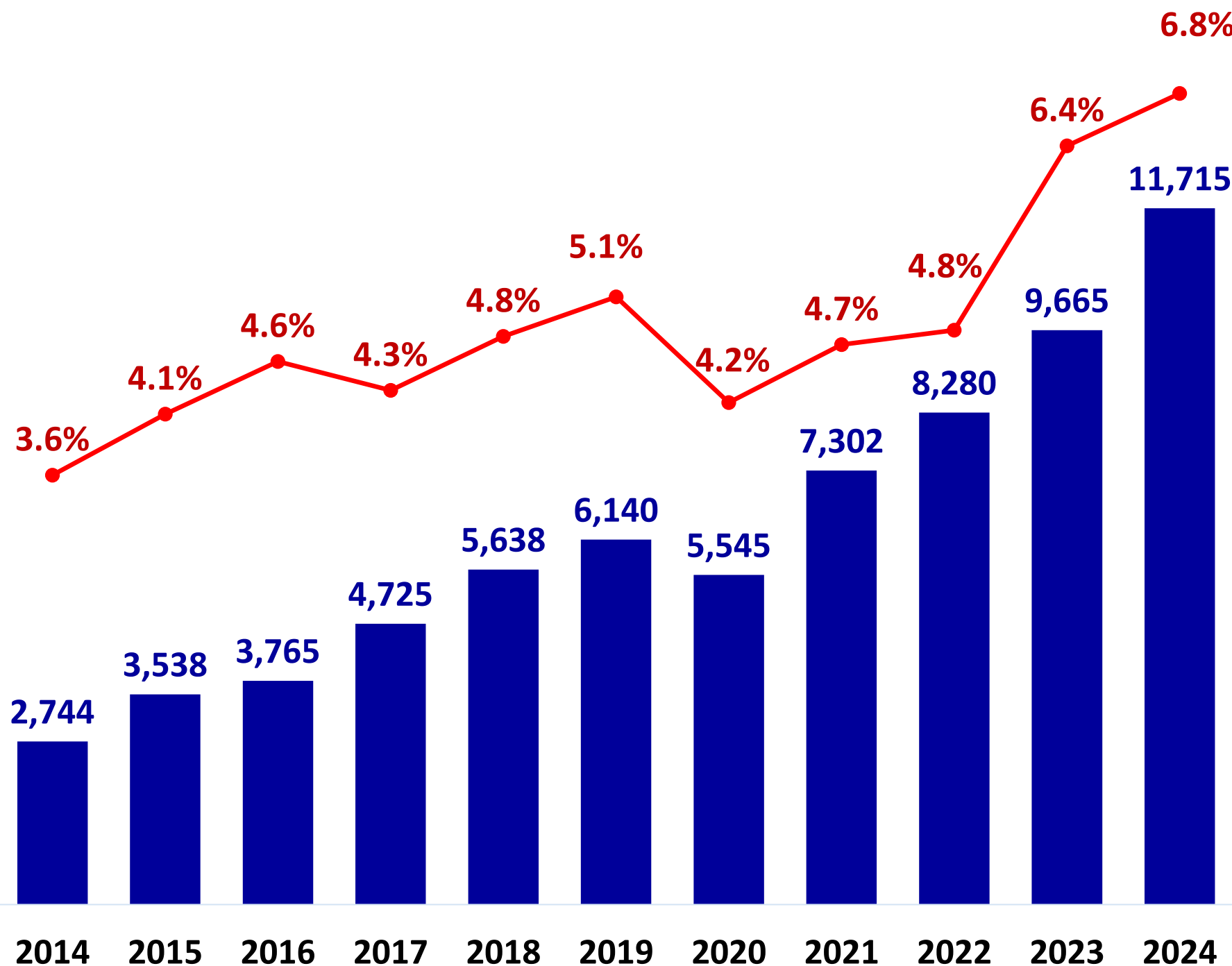
2030目標

全球前10

深化與客戶及產業鏈夥伴合作，目標每年創造優於產業平均的營收與獲利成長

持續投入高階產品研發，鞏固產業領導地位

■ 研發費用 ● 研發費用佔營收比例 (%) 單位：新台幣百萬元



在印刷電路板和半導體相關開發計畫上，臻鼎遵循12字方針，研發高階技術並引入到各項具有前瞻性之領域應用中。

12字方針：

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| 輕 輕型化 | 薄 薄型化 | 短 流程短 | 小 小型化 |
| 高 高頻、
高速、
高散熱 | 低 低污染、
低成本、
低功耗 | 多 多功能、
多層 | 快 快速研發、
快速製造 |
| 精 公差精進 | 美 美觀 | 細 細線路 | 智 智能化 |

實施台灣及大陸雙研發中心，持續提升新技術開發能力，以保持高端產品及技術之領先優勢。



臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

擴產有依，穩健前行，
搶占市場先機

擴產規劃



大陸廠區

- 2025下半年至2028年將投入人民幣80億元，在淮安園區擴充高階PCB產能。
- 規劃至2026年底，淮安園區iHDI與HLC產能將較現在翻倍成長。



泰國巴真府廠區

- 泰國一廠於5/8試產，目前量產爬坡進展順利，預期2Q26達到滿產。
- 目前泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔中心四座廠房同步建置，滿足客戶不斷上升的高階AI產品需求。



高雄AI園區

- 投入新台幣80億元購置IC載板生產設備，建置全流程之最先進封裝用FCBGA量產場域。
- 投入新台幣20億元購置iHDI+HLC PCB 生產設備。
- 軟板產線已開始量產，並貢獻營收。

提升營運效益之策略

- 各廠區分階段導入智慧工廠與數位轉型，提升營運效率，確保單位人均產值有效提升，進一步提升整體獲利率與競爭力。
- 目前已通過多家客戶認證，尚有多家伺服器與光通訊全球領先客戶正積極進行認證中。泰國一廠以高階iHDI、HLC、及光通訊模組產品為主，量產後有助於優化產品組合，提升毛利率。
- 規劃生產超高階產品(30L~80L)。
- 高雄AI園區之高階ABF載板與iHDI+HLC產能陸續裝機試車，將於1Q26進入打樣階段。

多元生產基地建置高階產能，滿足全球客戶需求

印度



清奈園區

FPC先進模組



泰國



巴真府園區

2025/5/8試產

大陸 深圳



深圳第一園區

FPC與先進模組/HDI



深圳第二園區

FPC先進模組

大陸 秦皇島



秦皇島園區

FPC與先進模組/
SLP高階 HDI

大陸 淮安



淮安第一園區

RPCB/HDI



BT載板園區

FC-CSP/WB-CSP/
Memory，第一期
2022年量產



淮安第二園區

FPC與先進模組/
HDI/Mini LED 背光
超薄細線路電路板



淮安第三園區

高階 HDI/MSAP，
2023年量產

台灣



高雄AI園區

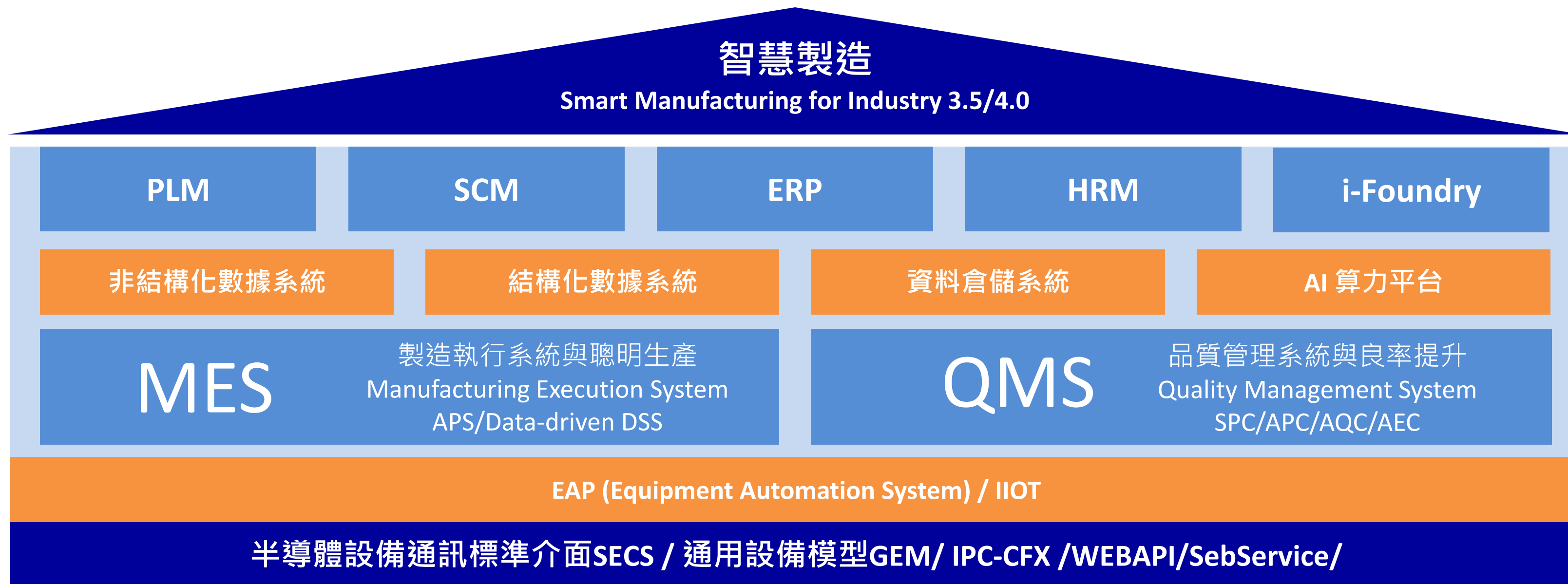
AI產品之研發暨生
產據點



ABF載板園區

第一期2023年量產

透過智慧製造，提高人均產值，創造更佳獲利



壓合



雷射



曝光 LDI



垂直顯影



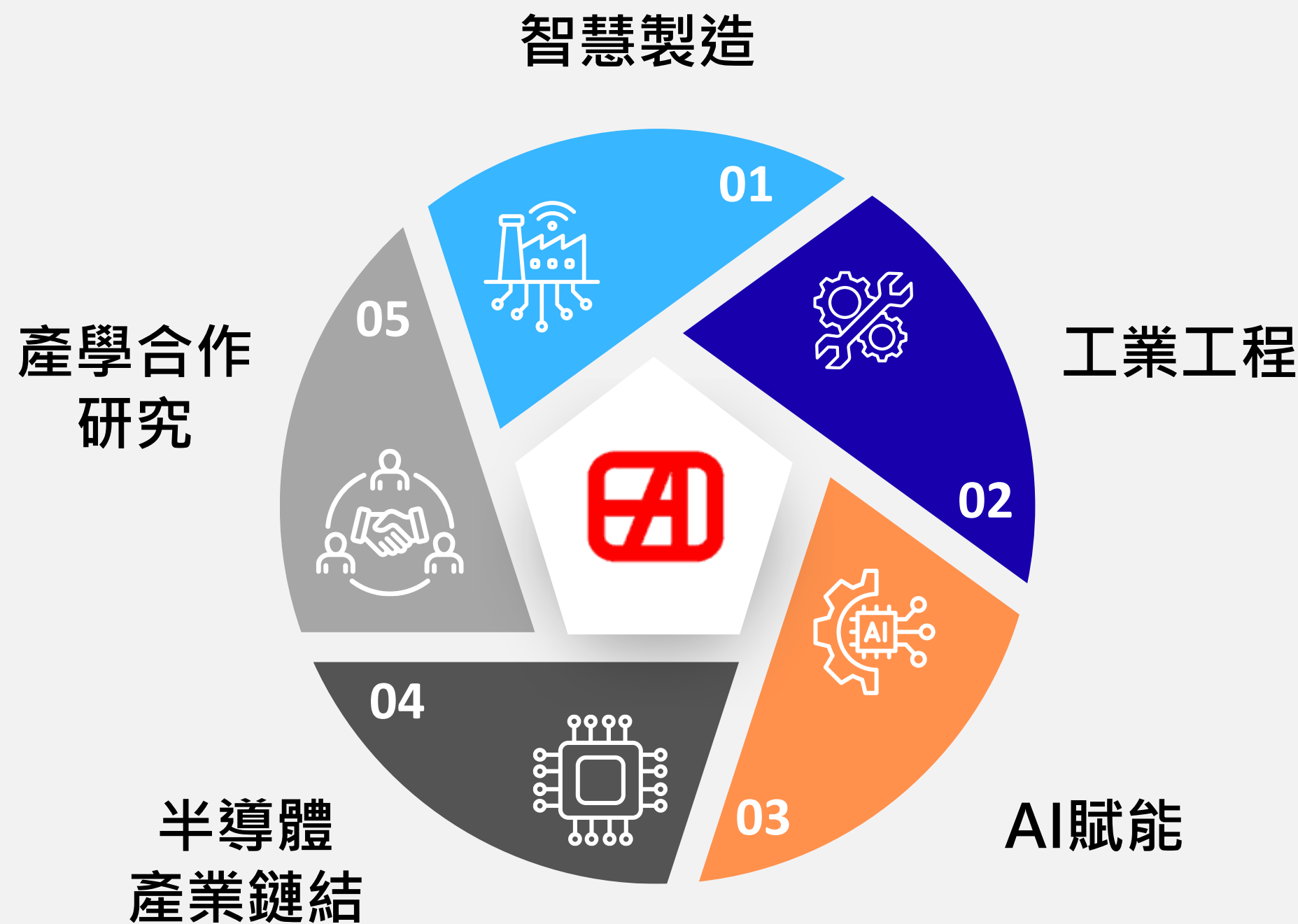
防焊印刷



電測

作業數位化、數位平台化、平台智能化、智能實戰化

團隊賦能，全面強化臻鼎營運韌性與永續競爭力

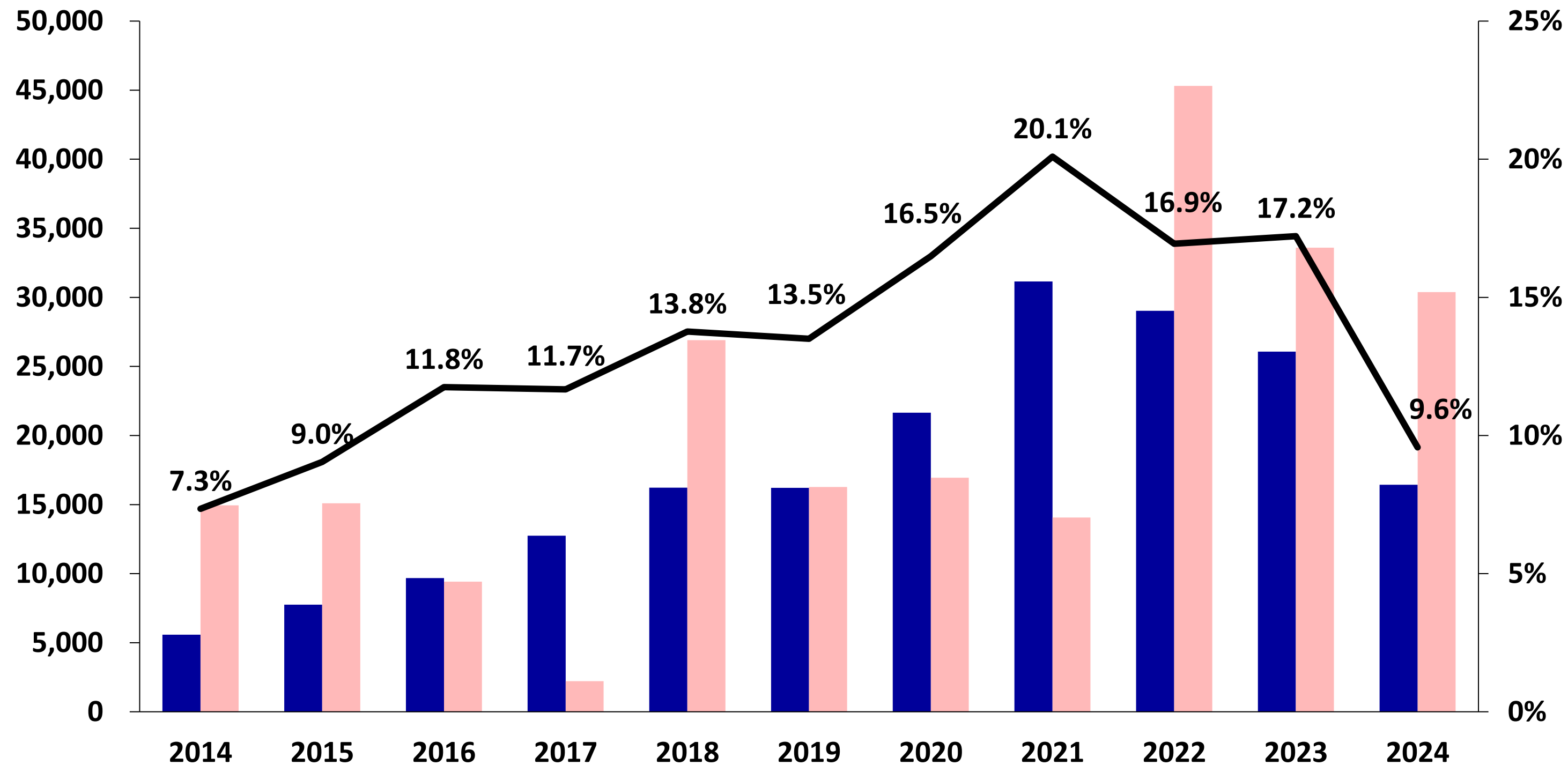


提高組織內外資源整合，
實現團隊賦能與結構性優化

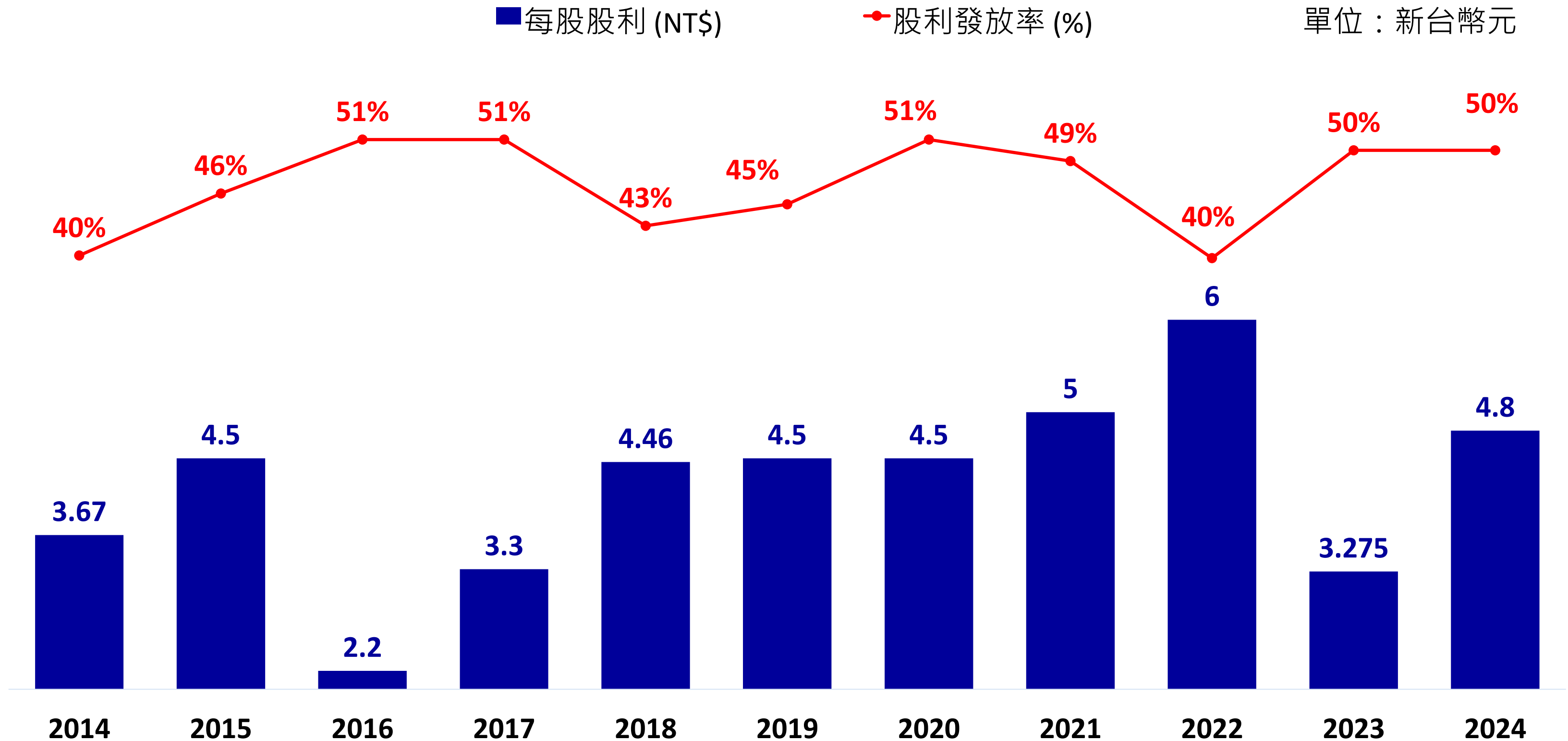
以強勁的現金流審慎支應資本支出， 穩健面對總體環境變化

單位：新台幣百萬元

■ 資本支出 ■ 來自營運之現金流量 — 資本支出/營收 (%)



維持高股息發放率，與股東共享經營成果



▶ 臺灣公司治理評鑑

2025年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度入選臺灣證券交易所公司治理100指數。

▶ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2025年S&P Global ESG 評級進步至85分，2022年至2024年連續3年入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)，為台灣唯一入選的PCB企業。

▶ Sustainalytics ESG 風險評級

最新Sustainalytics ESG風險評級為16.1，為低等風險等級。

▶ ISS ESG 評級

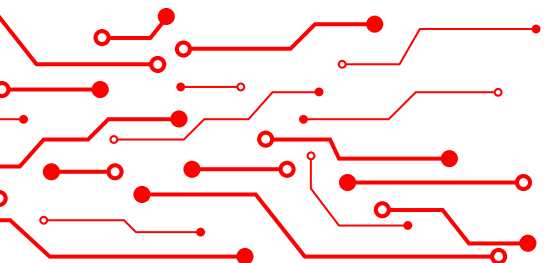
最新年度的ISS ESG評級由「C」進步至「C+」，獲得「優秀 (Prime)」等級。

▶ CDP 碳揭露專案

2024年在水安全管理獲得「A」最高等級殊榮，較去年進步一等級。在氣候變遷獲得「B」等級。

▶ 富時羅素 FTSE Russell ESG

最新年度的FTSE Russell ESG評級獲得4.5分（滿分為5分），成為台灣PCB企業第一名。

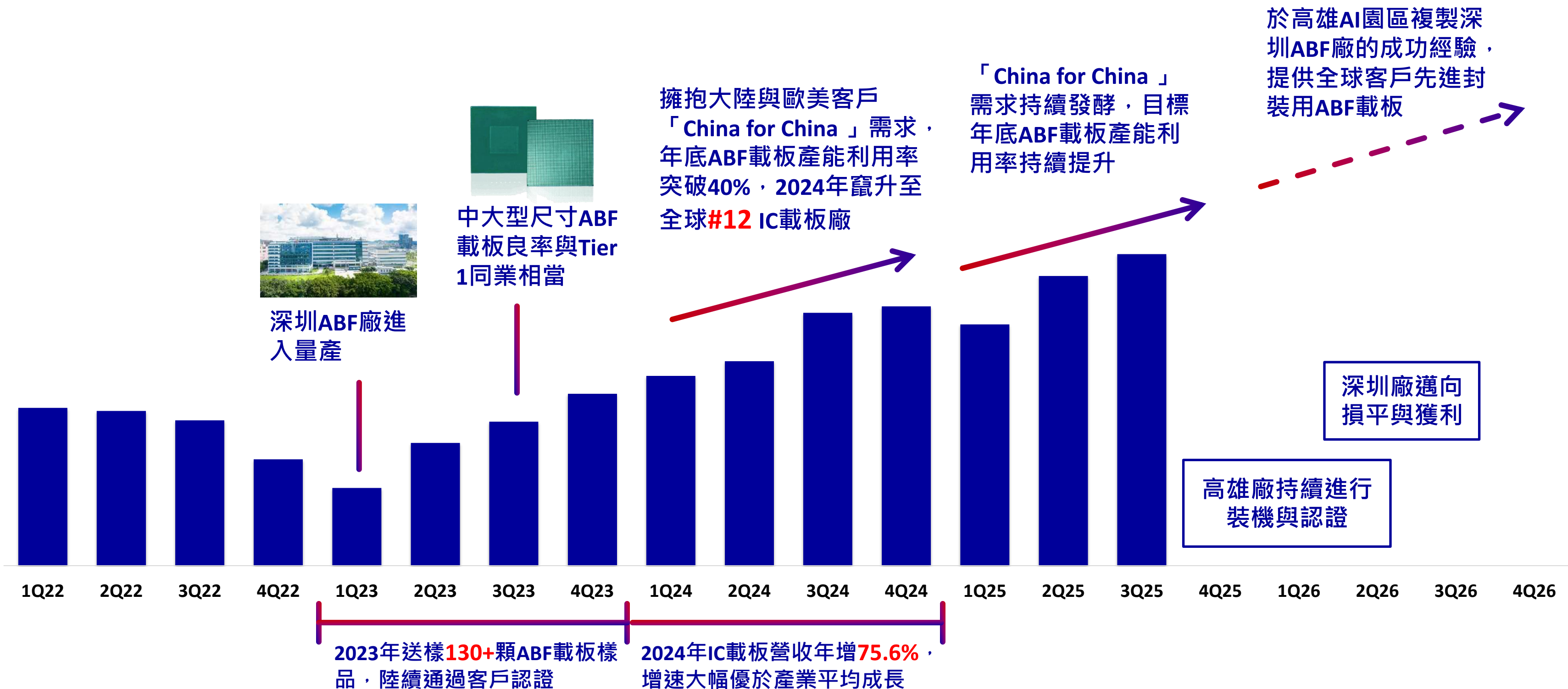




以先進技術領航，
IC載板業務快速成長

擁抱「China for China」需求， 同時以先進封裝用ABF載板擴大Outside China客戶群

臻鼎IC載板營收趨勢



目標2030年躋身全球前五大IC載板廠

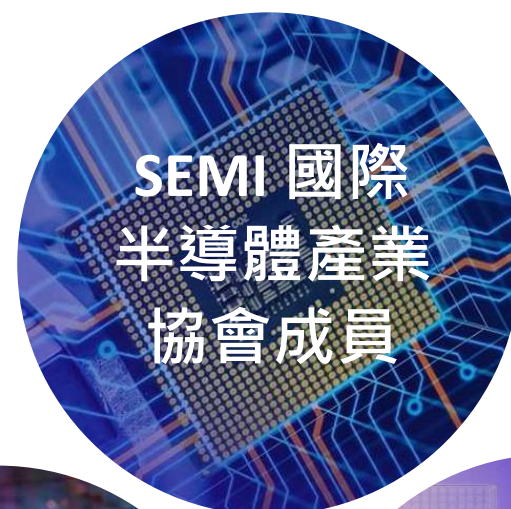
專注高階需求

- 以業界最先進的IC載板生產基地，專注客戶高階需求。
- 受惠於AI、高速運算與先進封裝技術的快速發展，高階ABF載板在大尺寸(70mm*70mm以上)及高層數(16層以上)產品需求持續成長。



串聯半導體產業鏈

- 積極參與半導體產業相關組織，與上下游企業密切合作，拓展在新興技術領域的市場機會。



複製大陸經驗至高雄AI園區

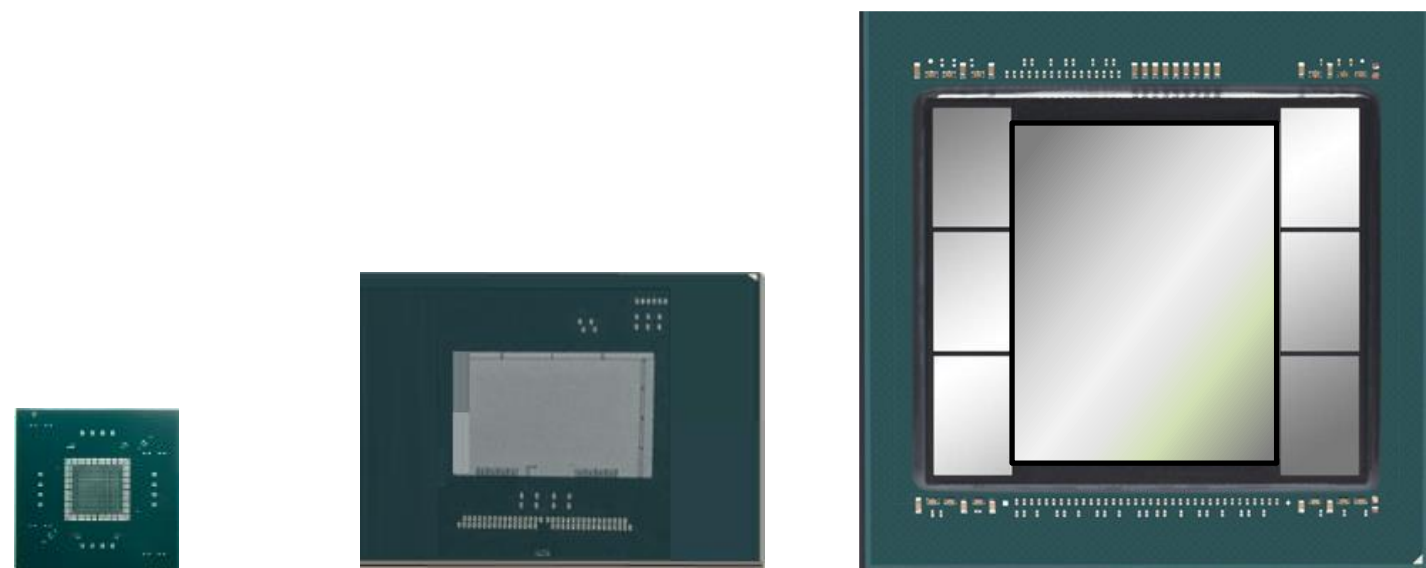
- 大陸廠區以高品質、高良率、高效率深受客戶肯定，產能利用率持續拉升。
- 將複製大陸成功經驗，於高雄AI園區建置全流程之先進封裝用FCBGA量產場域，重點開發分布於亞洲與歐美的指標型半導體客戶。
- 臻鼎為首家進入台灣科學園區的PCB廠，在技術與環保方面符合高標準。



臻鼎ABF載板技術能力與Tier 1競爭者相當， 致力爭取全球領先半導體客戶

ABF載板發展趨勢

層數**高**、尺寸**大**、表面**平**、產品精度**準**



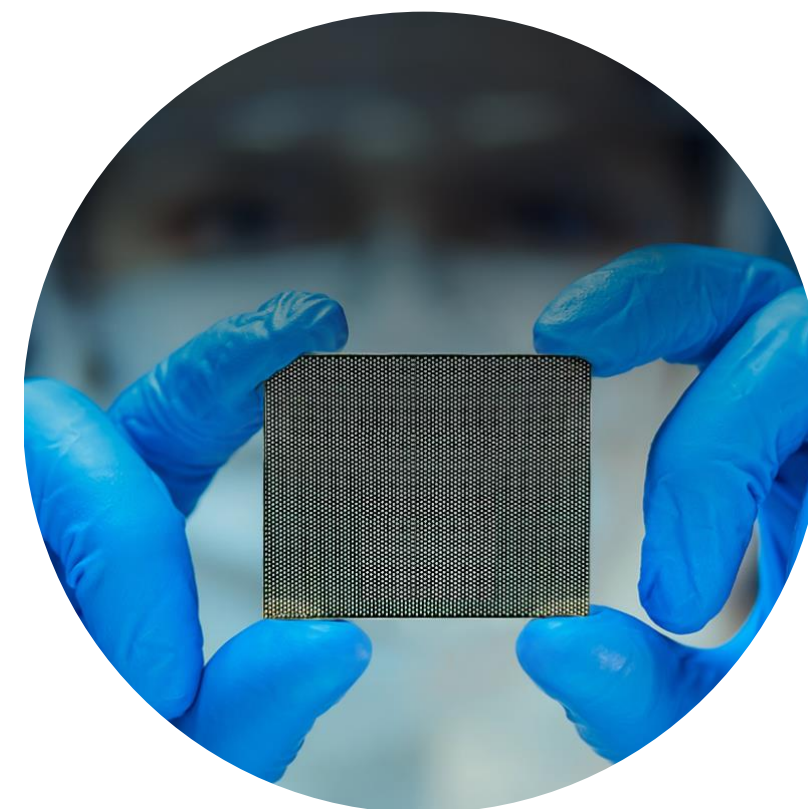
2005

2020

2026

Body Size (mm)	31 x 31	75 x 60	120 x 140+	x20+
Layer count (L)	6	20	28+	x4+
Bump Count	1K	100K	300k+ ~ 500k+	x300+

臻鼎技術能力已達
產業領先水準



營運成果摘要

第三季營運成果

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	3Q25	3Q24	年變化 (%)
營業收入	47,366	50,609	-6.4%
營業毛利	10,410	11,406	-8.7%
營業毛利率	22.0%	22.5%	-0.5ppts
營業費用	5,880	5,473	+7.5%
營業利益	4,530	5,933	-23.6%
營業利益率	9.6%	11.7%	-2.1ppts
營業外收入及支出	131	(655)	
本期淨利	3,589	4,751	-24.5%
淨利率	7.6%	9.4%	-1.8ppts
歸屬於母公司之淨利	2,392	3,353	-28.7%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	2.46	3.52	
折舊及攤銷	4,522	4,517	+0.1%
營運活動之現金流入	(2,847)	(712)	
現金及約當現金 ⁽²⁾	76,608	64,714	+18.4%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	9.4%	13.7%	-4.3ppts

附註：(1) 2025年前三季加權平均流通在外股數為973,212仟股 (實際發行股本1,040,623仟股-庫藏股424仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

前三季營運成果

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	1-3Q25	1-3Q24	年變化 (%)
營業收入	125,652	115,531	+8.8%
營業毛利	23,306	20,990	+11.0%
營業毛利率	18.5%	18.2%	+0.3ppts
營業費用	15,296	14,958	+2.3%
營業利益	8,011	6,032	+32.8%
營業利益率	6.4%	5.2%	+1.2ppts
營業外收入及支出	379	1,253	-69.7%
本期淨利	6,002	6,855	-12.4%
淨利率	4.8%	5.9%	-1.1ppts
歸屬於母公司之淨利	3,629	4,816	-24.6%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	3.79	5.08	
折舊及攤銷	13,777	13,094	+5.2%
營運活動之現金流入	15,407	9,404	+63.8%
現金及約當現金 ⁽²⁾	76,608	64,714	+18.4%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	5.2%	6.6%	-1.4ppts

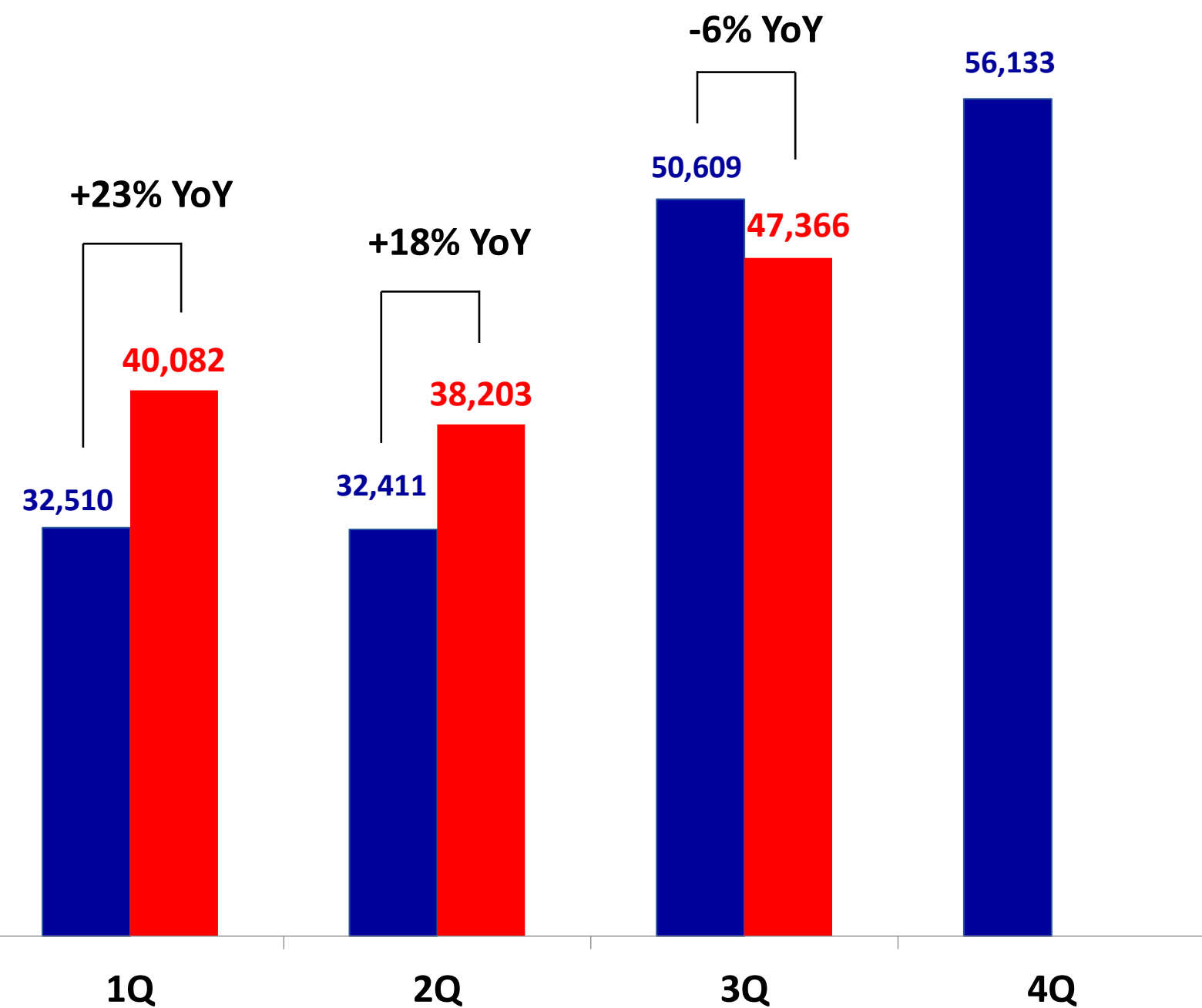
附註：(1) 2025年前三季加權平均流通在外股數為957,280仟股 (實際發行股本1,040,623仟股-庫藏股424仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

季度營運成果

營業收入

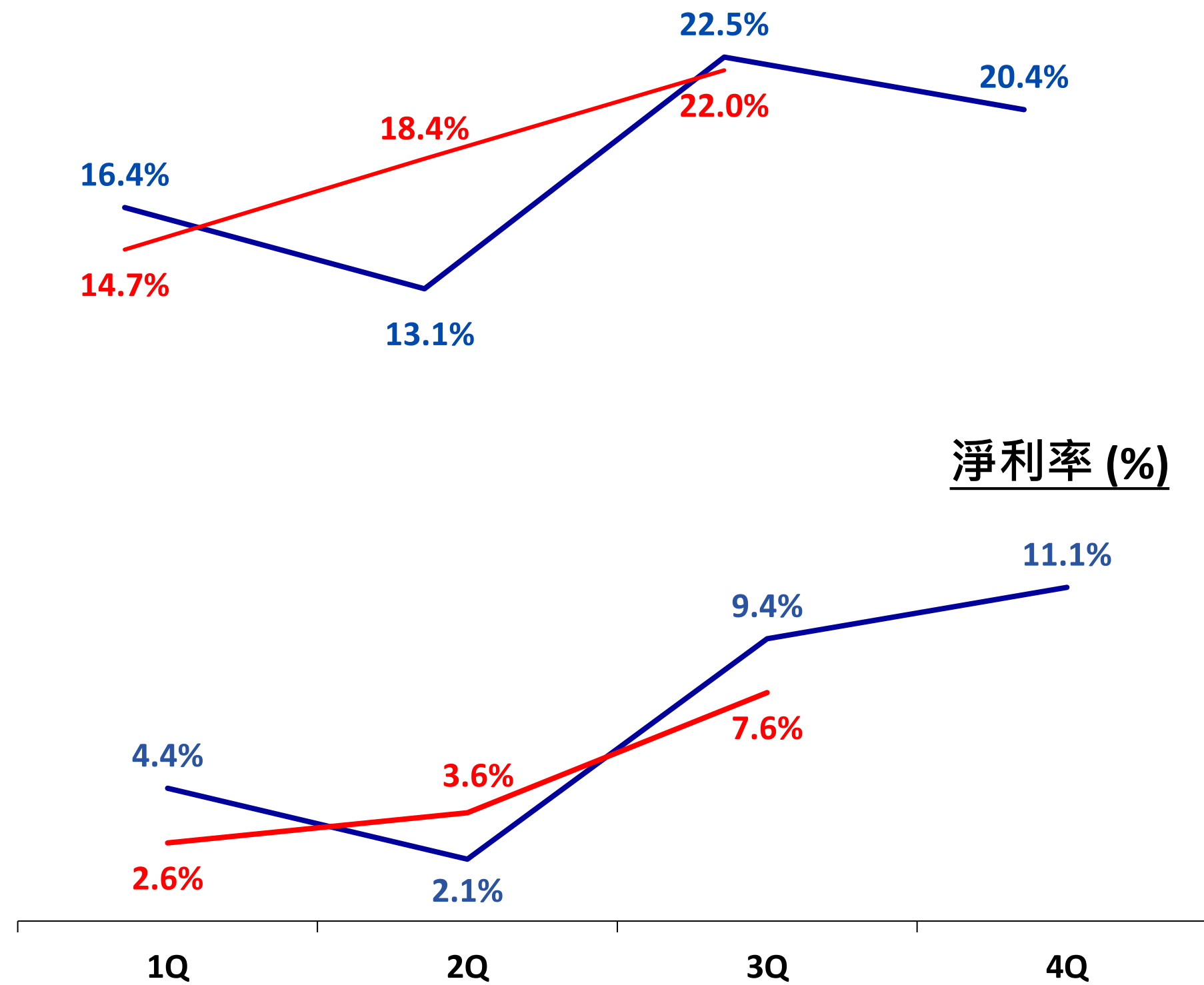
■ 2024 ■ 2025

單位：新台幣佰萬元

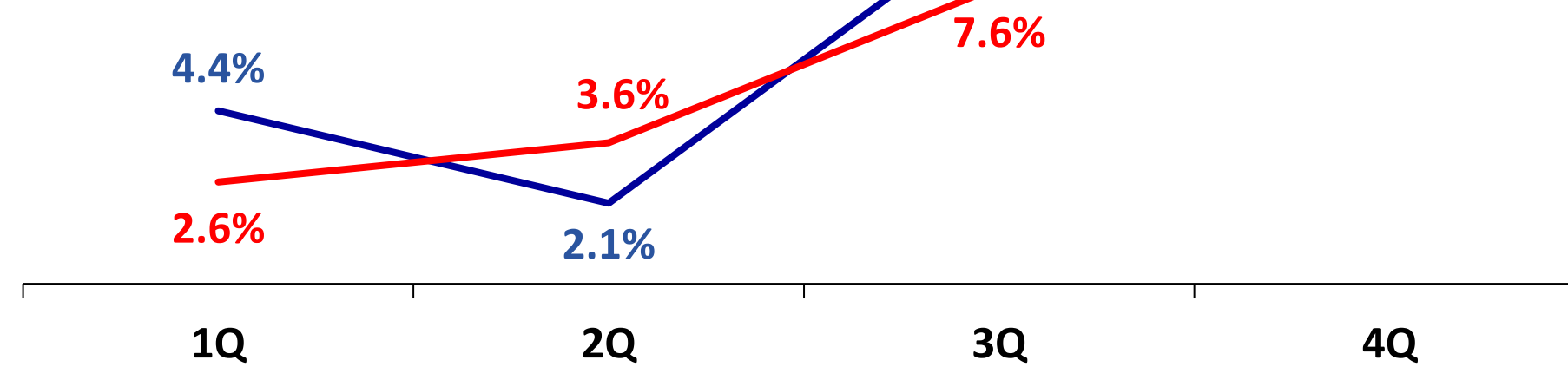


毛利率 (%)

— 2024 — 2025

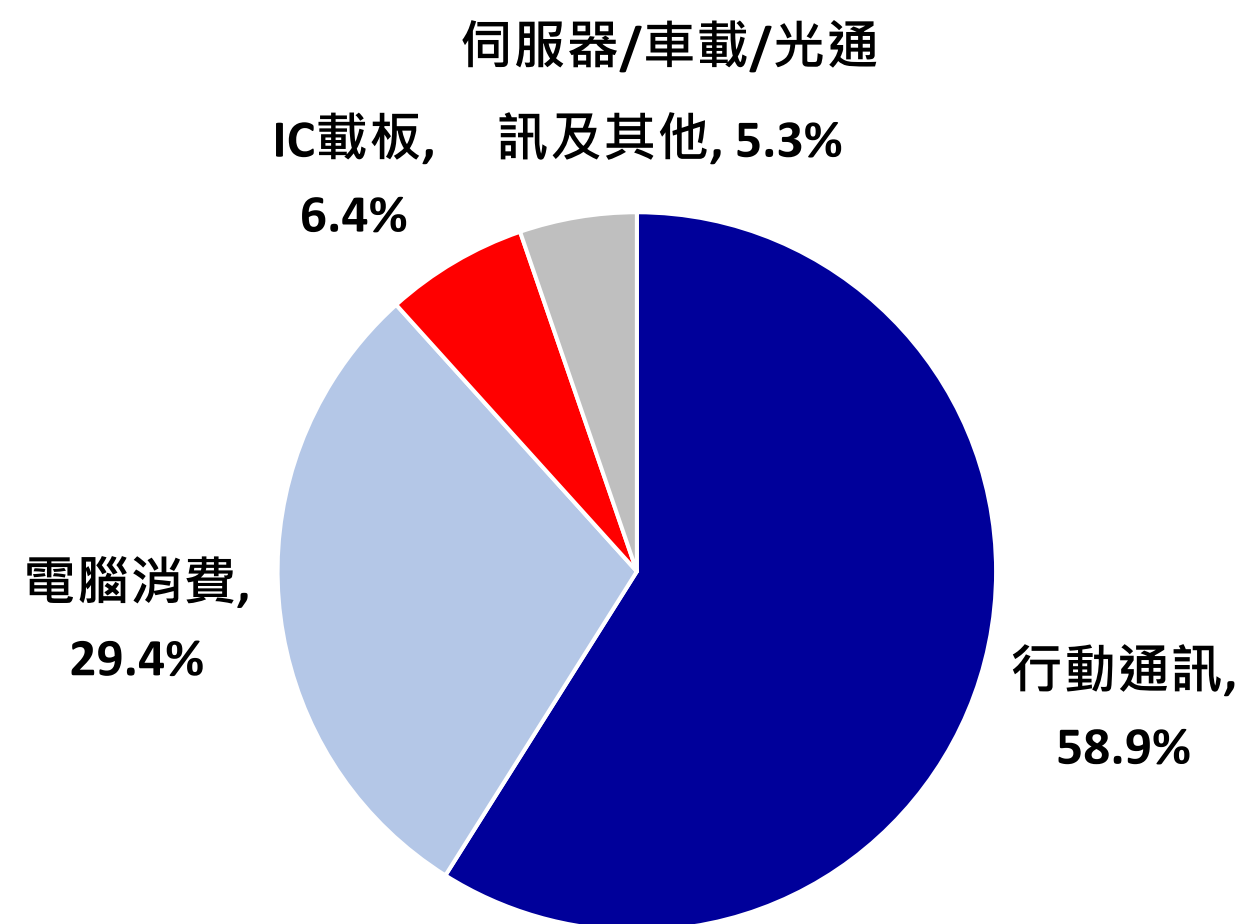


淨利率 (%)

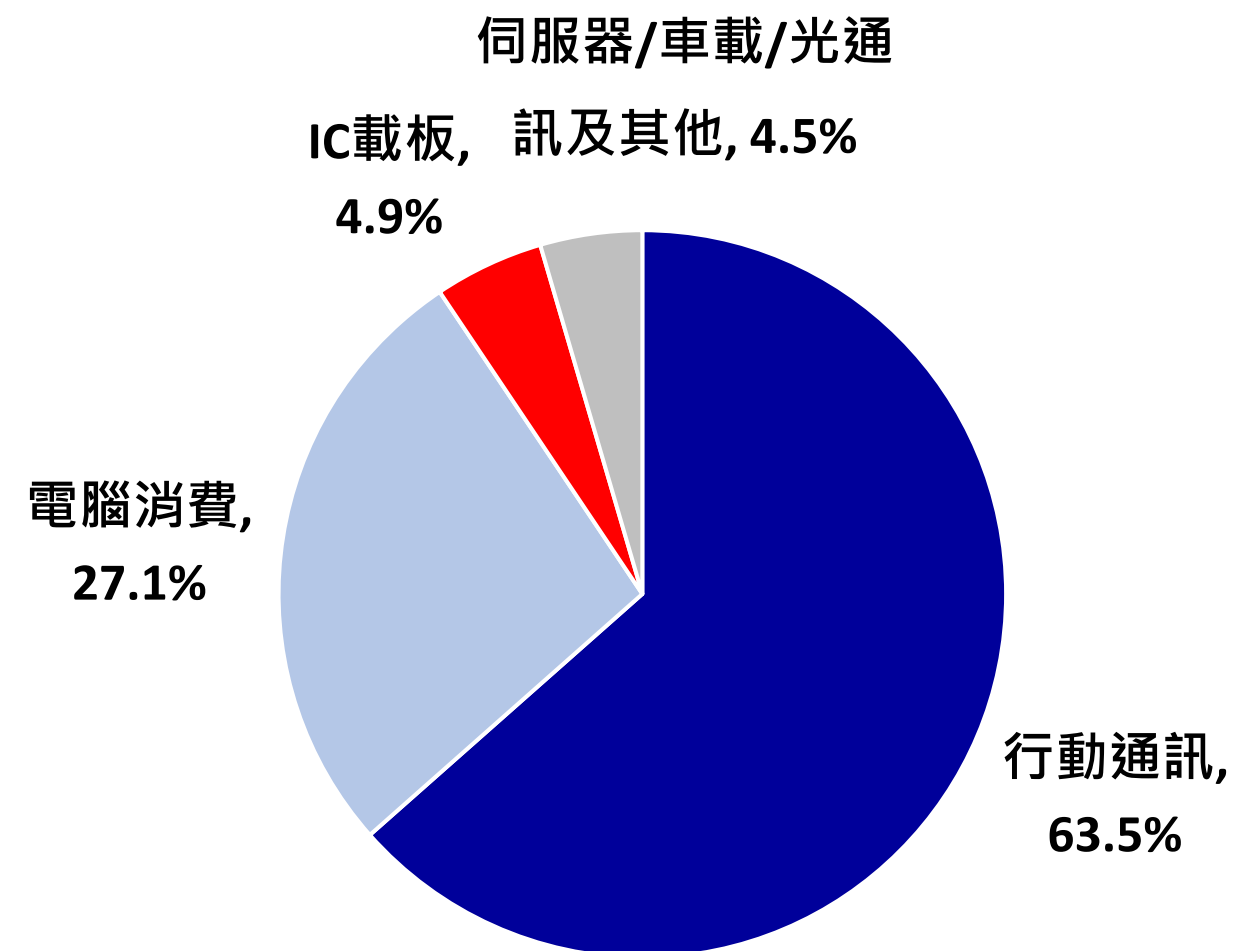


銷售分析-產品應用別

3Q25營收：新台幣474億



3Q24營收：新台幣506億



資產負債表及重要財務比率

 單位：新台幣佰萬元
 差異

	2025-9-30		2024-9-30		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 ⁽²⁾	76,608	27.9%	64,714	24.9%	11,894	+3.0ppts
應收款項	30,609	11.1%	35,675	13.7%	(5,066)	-2.6ppts
存貨	22,420	8.2%	24,799	9.5%	(2,379)	-1.3ppts
不動產、廠房及設備 ⁽³⁾	118,742	43.2%	111,026	42.8%	7,716	+0.4ppts
資產總額	274,788	100.0%	259,685	100.0%	15,103	
借款	63,999	23.3%	56,260	21.7%	7,739	+1.6ppts
應付款項	43,510	15.8%	43,776	16.9%	(266)	-1.1ppts
負債總額	120,979	44.0%	115,599	44.5%	5,380	-0.5ppts
股東權益總額	153,809	56.0%	144,087	55.5%	9,722	+0.5ppts
重要財務比率						
平均收現日數(天)	66		77		(11)	
平均銷貨日數(天)	57		62		(5)	
流動比率(倍)	1.59		1.78		(0.19)	
資產生產力(倍) ⁽⁴⁾	1.44		1.39		0.05	

附註：(1) 2025年前三季加權平均流通在外股數為957,280仟股 (實際發行股本1,040,623仟股-庫藏股424仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。(3) 不動產、廠房及設備 包含 投資性不動產。(4) 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

歷年營運成果

單位：新台幣佰萬元

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
營業收入	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356	151,398	171,664
營業毛利	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888	27,459	32,461
本期淨利	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535	9,432	13,096
母公司淨利	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197	6,189	9,180
折舊及攤銷	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638	16,323	17,749
每股盈餘 (元)	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02	6.55	9.67
每股股利 (元)	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00	3.275	4.80
分派比率 (%)	46%	51%	51%	43%	45%	51%	49%	40%	50%	50%
現金及約當現金 *	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599	65,970	79,830
不動產、廠房及設備	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814	109,965	113,462
資本額	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470	9,470	9,567
股東權益報酬率 (%)	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%	7.10%	9.15%
負債比率 (%)	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%	44.67%	42.85%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



Thank You